

# CLEALITE

Metal Ultra  
Super Polish



该照片是示意图。This photograph is an image.

## ■CLEALITE

CLEALITE S 系列是用于铜、铝、不锈钢以及钛等各种金属的镜面加工所用的研磨材料。

S 系列用分散性良好的氧化硅粉作为主原料并配置减少划伤以及橘皮等表面质量的其他成分，从而缩短加工时间以及提高表面质量。

## ■CLEALITE

CLEALITE Series polishing materials are designed for planarization of various kinds of copper, stainless steel and titanium alloys.

CLEALITE S enables shorter polishing times and superior surface finish performance with its well-balanced composition of different silica abrasives and achieves reduced defects including scratches and orange peel.

## CLEALITE的代表物性 Typical Physical Properties of CLEALITE

项目 Item	产品名 Type	S
平均粒径、SEM Average particle size(μm)		72.0
pH		8.8
比重 Specific gravity		1.200

# 金属、金属氧化物用 研磨液 (CLEALITE 系列)

CLEALITE 系列是为了平坦各种金属，蓝宝石，AL阳极氧化膜等的金属氧化物表面所开发的研磨材。能有效地去除机械加工痕和成型痕并能获得均匀的平滑面。最适合一般工业部品，装饰品，LED衬底片，蓝宝石防护面板表面的加工痕去除以及增加平滑性，光泽度和质感。

- 1) 使用特殊氧化铝颗粒因此拥有高加工能力
- 2) 粒径大小均匀因此能获得无缺陷的表面
- 3) 有着优越的清洗性能对后续工艺影响小

### (研磨对象)

CLEALITE 10, 51, 100 : Al, Ti, SUS 等各种合金  
 CLEALITE 35 : 蓝宝石 (c向)



该照片是示意图。

### (产品种类和其特性)

产品		CLEALITE 10	CLEALITE 51	CLEALITE 100	CLEALITE 35
特性		高平滑度	标准移除量	高移除量	高移除量 高平滑度 单面研磨用
颗粒	种类	氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝
	大小	0.2-0.5 μm	1-2 μm	2-5 μm	0.5-1.0 μm
pH [-]		2 - 3	2 - 3	2 - 3	12.5 - 13.5
建议稀释率		1 - 2	1 - 3	1 - 3	3
用途例子	粗抛		Al, SUS, Ti Ra : 20-30nm	Al, SUS, Ti Ra : 30-50nm	
	精抛	(SUS, 阳极氧化层) Ra : <10nm			蓝宝石 (c向) Ra : <0.3nm

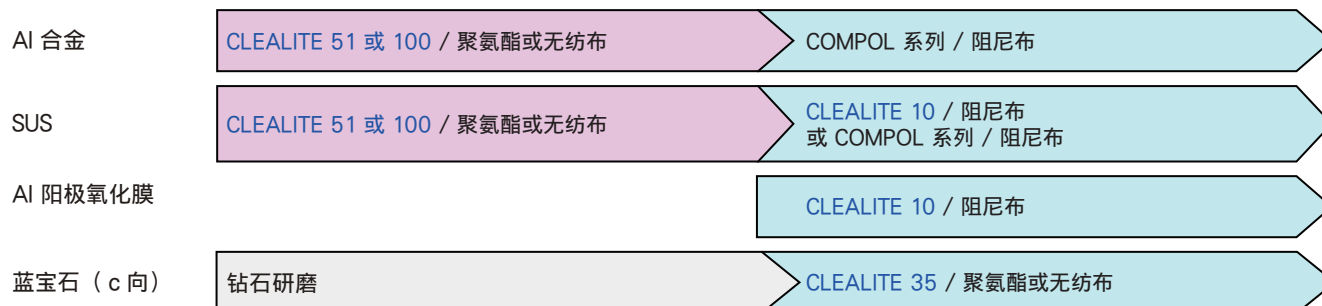
### (建议使用抛光布)

金属粗抛 : 聚氨酯, 无纺布  
 金属精抛 : 阻尼布  
 蓝宝石 (c向) : 聚氨酯, 无纺布

### 【粗抛研磨制程】

### 【粗抛研磨制程】

### 【精抛研磨制程】



<有关此产品的咨询>  
 FUJIMI INCORPORATED  
 〒509-0109 岐阜県各務原市 TECHNO PLAZA 1-8  
 TEL (058) 379-3170 FAX (058) 379-3171